

便簽 日期：
單位：研究發展處

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

學術發展組擬辦：

一、文陳閱後，公告於學校首頁最新消息及本處訊息公告。

二、文存。

會辦單位：

第二層決行	承辦單位	會辦單位	決行
	 115. 7. 15		
			
			

正本

研學術發展處
學術發展組

中華民國台灣半導體產業協會 函

機關地址:新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 53 館 802 室

聯絡人及電話: 石英堂協理, 03-5917092

受文者: 國立中興大學

速別: 最速件

密等及解密條件: 無

發文日期: 中華民國 115 年 7 月 13 日

發文字號: (115) 導協字第 033 號

附件: 2026 TSIA 半導體設備創新獎得獎名單

主旨: 檢送本會「2026 TSIA 半導體設備創新獎」得獎名單, 請惠予公告。

說明:

- 一、本會所舉辦之「2026 TSIA 半導體設備創新獎」甄選活動已由本會設備委員會遴選小組, 秉著公平嚴謹的原則, 順利完成所有的評審作業, 得獎名單(如附件)。
- 二、本獎項審核重點包含與設備實際相關的合作創新成果, 先行設計優化改善創新製程導向系統整合軟體定義(software defined; equipment centered; process oriented)等。
- 三、本得獎名單已於 2026 年 6 月 26 日公告於本會官網 www.tsia.org.tw, 並通知得獎者。
- 四、本會將於 2026 年 10 月 29 日「2026 TSIA 年會」公開表揚與頒獎, 同時發佈新聞稿, 供社會大眾知悉。
- 五、衷心希望 貴校繼續鼓勵優秀學生參加甄選, 為台灣半導體產業之發展而戮力前進。

正本: 國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立中山大學、國立台北科技大學、國立臺灣科技大學、國立高雄科技大學、國立聯合大學、逢甲大學、明志科技大學

副本:



符合本校「文書處理要點」第18條、33條規定, 以紙本公文辦理。

理事長侯永清

總收文
115.7.14

國立中興大學



1150052949

TSIA 半導體設備創新獎

因應 AI 時代來臨，先進封裝需求日趨重要，相關設備成為技術突破與競爭力的重要關鍵，TSIA 為鼓勵學界積極投入從事半導體設備相關之研究、發明、優化並積極參與產業合作，促進設備本土化及升級轉型，於 2026 年開始成立 TSIA 半導體設備創新獎，希望藉由獎項的頒發鼓勵學校，積極投入半導體設備的產學合作。提升本土半導體設備的專業能力。

本獎項審核重點包含與設備實際相關的合作創新成果，先行設計優化改善創新製程導向系統整合軟體定義(software defined; equipment centered; process oriented)等。誠摯邀請國內大專院校相關研究團隊報名申請，展現亮麗的研究成果。

2026 TSIA 半導體設備創新獎得獎名單

得獎者	學校	系所	實驗室	成員	學校	系所	實驗室	成員	學校	系所	實驗室	成員
	明志科技大學	機械工程系	智慧醫療研究中心	洪國永 廖浩延 王聖榮	逢甲大學	工程科學學院	綠色動力實驗室	王啟昌 陳鉅堯 梁佑嘉 古如恩	陽明交通大學	電子研究所	碳化矽功率元件實驗室	溫宇新 宋維倫 許珈展
得獎理由	其研究團隊協助先進封裝設備廠商針對 Bonding 製程之關鍵組件，提供高效解決方案，大幅提升設備整體穩定性。				其研究團隊透過熱與固力模擬分析及 AI 技術協助先進封裝設備廠商改善各式加熱爐之加熱系統與節能問題。				其研究團隊自主完成高速開極驅動量測架構並提升效能，達成穩定低失真的高速開極切換訊號輸出，可支援 Si 及 SiC 等元件的動態特性量測需求。			

**感謝 2026 TSIA 半導體設備創新獎 獎金贊助單位：台灣電子製造設備工業同業公會